дис. ... д-ра техн. наук: 05.14.04 / Е. Г. Гашо; Нац. исслед. ун-т МЭИ. -M., 2018. -40 c.

## ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК-ПАРАЭЛЕКТРИК КЕРАМИК НА ОСНОВЕ ТИТАНАТА-ПИРКОТТ

Одним из методов получения новых материалов является метод холодного (при комнатной температуре) прессования при высоких давлениях (ВДХП). Например, титанат свинца в виде керамики был получен только с помощью этого метода [1, 2]. ВДХП оказывает влияние на особенности фазовых переходов (ФП) и кристаллической структуры, что в итоге определяет физические свойства материала.

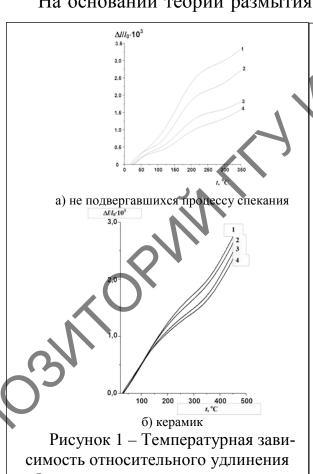
В настоящее время существует новое направление в области синтеза материалов [3, 4]. При использовании высоких давлений (свыше 20 ГПа) были получены соединения ранее не существовавшие (NaCl<sub>7</sub>, NaCl<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S и др.). Ученые, используя алгоритм прогнозирования криструктуры USPEX В сочетании сталлической механическими вычислениями минимальных энергий для устойчивости кристаллической структуры, смогли сформулировать основные принципы сохранения стабильности новых соединений.

Данная работа посвящена изучению влияния высокого давления холодного прессования (1-5 ГПа) на фазовый переход сегнетоэлектрик-параэлектрик в керамических материалах на основе цирконататитаната свинца с ромбоэдрической кристаллической структурой.

Для исследования поведения фазовых переходов в зависимости от величины ВДХП использовались дилатограммы образцов цирконататитаната свинца с ромбоэдрической кристаллической структурой, полученные в лаборатории электронной керамики ГНПО "НПЦ НАНБ но материаловедению". На кривых термического расширения для неспеченных образцов (рисунок 1, а) наблюдаются два ФП в районе температур 110°C и 310°C. Для подвергнутых процессу спекания (керамических) образцов — один в районе  $350^{\circ}$ С (рисунок 1, б). Полученные результаты говорят о том, что в твердом растворе цирконататитаната свинца после синтеза присутствует две фазы: низкотемпературная и высокотемпературная модификации ромбоэдрической кристаллической решетки. В районе  $110^{0}$ C (рис. 1, a) происходит фазовый переход низкотемпературной СЭ фазы в высокотемпературную СЭ фазу. Процесс спекания значительно уменьшает концентрационные градиенты внутри зерен, что приводит к однофазности керамических образцов, которые содержат только высокотемпературную СЭ фазу (рисунок 1, б).

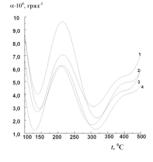
Полученные путем дифференцирования экспериментальных данных для  $\Delta l/l_0(t)$  температурные зависимости коэффициентов линейного теплового расширения а (КЛТР) (рис. 2) проходят через конечный экстремум в области фазового перехода из сегнето- в параэлектрическую фазу. При этом температура СЭ ФП для неспеченных образцов (рисунок 2, а) не имеет четкой зависимости от давления, в то время как для керамик при увеличении ДХП фазовый переход наблюдается при более низких температурах ( $p = 1 \ \Gamma \Pi a - t_c = 336 \ C$ ; для  $p = 4 \ \Gamma \Pi a$  $-t_{c}=323^{0}$ C).

На основании теории размытия  $\Phi\Pi$  (Исупова-Смоленского) [5, 6]

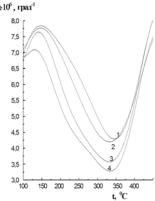


образцов полученных с использованием ВДХП:

1 - 1 ΓΠa; 2 - 3 ΓΠa; 3 - 4 ГПа;4 - 5 ГПа



а) не подвергавшихся процессу спекания



б) керамик

Рисунок 2 – Температурная зависимость коэффициента линейного теплового расширения образцов, полученных с использованием ВДХП:

$$1-1$$
 ГПа;  $2-3$  ГПа;  $3-4$  ГПа;  $4-5$  ГПа

проведена количественная оценка степени размытия  $\xi$  фазовых переходов керамических образцов двумя методами. Используя экстремальные значения  $\alpha_{\rm ah}(t_{\rm c})$  КЛТР, фактор размытия  $\xi$  ФП вычислялся по формуле:

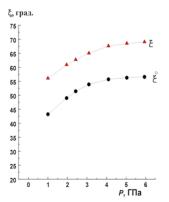


Рисунок – 3 Зависимости степени размытия ФП от ДХП для керамических образцов

$$\xi = \frac{1}{4} \frac{1}{\alpha_{\text{aH}}(t_{\text{c}})} \frac{\Delta l_{c}}{l_{0}},$$

где  $\Delta l_{c}/l_{0}$  получено экстраполяцией зависимости  $\frac{\Delta l}{l_{0}}(t)$  к температуре  $\Phi\Pi$   $t_{c}$ . На основании связи степени размытия  $\Phi\Pi$  с "полушириной" D экстремума кривой  $\alpha(t)$  в области фазового перехода, фактор размытия равен:

$$\xi^{\rm D} = 0.284 D.$$

Установлено, что степень размытия СЭ ФП для неспеченных образцов практически не зависит от величины ВД и со-

ставляет  $\sim\!\!22$   $^{0}$ С. Очевидно, что в этом случае основной причиной размытия являются концентрационные флуктуации состава, и, в меньшей степени, микродеформации кристаллической решетки. Результаты вычислений для керамик в обоих методах (рис. 3) показали одинаковый характер изменения  $\xi$  в зависимости от величины ВД, хотя численные значения  $\xi$  различаются. При этом зависимость фактора размытия ФП от ВД наблюдается до 3,5 ГПа, что обусловлено ростом микродеформаций кристаллической решетки керамик при этих давлениях. Начиная с 3,5 ГПа, влияние ВД на величину  $\xi$  незначительное.

## Литература

- 1. Акимов, А.И. Уточнение параметров кристаллической структуры титаната свинца с различной степенью дефектности по катионной и анионной подрешеткам методом Ритвельда /А.И. Акимов, Г.К. Савчук, А.К. Летко, В.А. Рубцов// Кристаллография 2003. т.48 (2) С. 267-271.
- 2. Акимов, А.И. Керамические материалы (диэлектрические, пьезо-электрические, сверхпроводящие): условия получения, структура, свойства /А.И. Акимов, ГК Савчук// Минск: Изд. центр БГУ, 2012. 256c.
- 3. Бланк В. Д. Фазовые превращения в твердых телах при высоких давлениях/ В. Д. Бланк, Э И Эстрин// Физматлит, 2011. 412с.

- 4. Oganov A.R. Modern Methods of Crystal Structure Prediction / A.R. Oganov, Schön J.C., Jansen M., Woodley S.M., Tipton W.W., Hennig R.G.// Berlin: Wiley-VCH – 2010. – pp. 223-231.
- 5. Исупов В.А. Сегнетоэлектрики с размытым фазовым переходом и дипольные стекла // Изв. Ан СССР. Сер. физ. – 1990. – т.54, № 6. – C. 1131-1134.
- 6. Ролов, Б.Н. Физика размытых фазовых переходов /Б.Н. Ролов, Э. Юркевич// Изд.: Ростовский университет, 1983. 320с. В.Э. Юркевич// Изд.: Ростовский университет, 1983. 320с.

А. Д. Юник (БГУИР, Минск) Науч. рук. Я. А. Соловьёв, канд. техн. наук, доцент

## СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАЛЬНОЗАКРЫТЫХ GaN/AlGaN ТРАНЗИСТОРОВ С ВЫСОКОЙ подвижностью электронов

В настоящее время одной из наиболее важных социальных проблем в мире является неуклонный рост энергопотребления. Кремниевая (Si) технология, которая более ияти десятилетий являлась доминирующей при создании элементной базы для всех электронных устройств, начинает не справляться с возрастающими требованиями. В этой связи одним из наиболее перспективных направлений развития силовой электроники является реализация устройств на основе широкозонных полупроводников. Особый интерес здесь представляют нитриды элементов третьей группы таблицы Менделеева (GaN, AlN, InN-III-нитридов и др.), обладающие целым рядом уникальных свойств.

Одним из наиболее ярких на данный момент представителей изделий данного класса является транзистор с высокой подвижностью электронов (ТВПЭ). Благодаря своим превосходным свойствам, GaNAIGaN-транзисторы оказались способны с легкостью заменить мощные кремниевые полевые транзисторы в компактных импульсных источниках питания, DC/DC-преобразователях, разумных сетях электропитания, электроприводах и др.

Целью настоящей работы является решение задачи выбора способа формирования нормально-закрытых ТВПЭ (формирования затвора транзисторов данного типа), а также выбора типовой гетероструктуры для нормально-закрытых ТВПЭ на основе GaN/AlGaN.